



福懋科技股份有限公司
FORMOSA ADVANCED THCHNOLOGIES CO., LTD

2024年 Q2 法人說明會



FATC 記憶體最佳代工夥伴

總經理暨發言人 張憲正 || 2024年8月28日

免責聲明

簡報內容（含本會議中所揭露之資訊）含有若干預測性資訊，僅供參考之用。福懋科技股份有限公司或任何第三人均不就該預測性資訊之正確性與完整性承擔任何責任，亦不負更新或更正該資訊之義務，請您務必謹慎審閱以上資訊。如未經許可，亦請您切勿散播重製或揭露以上資訊之一部分或全部予第三人。



會議議程

- 1 2024年第2季營運績效及財務狀況
- 2 研究發展與規劃
- 3 營運重點與市場展望
- 4 問與答



福懋科技股份有限公司
FORMOSA ADVANCED THCHNOLOGIES CO., LTD



2024年第2季 營運績效及 財務狀況

2024年第2季財務摘要

單位:新台幣千元

項目	2024年第2季		2024年第1季		較上季差異		2023年第2季		較去年同期差異	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
會計科目										
營業收入	2,337,549	100.0	2,359,653	100.0	-22,104	-0.9	1,880,837	100.0	456,712	24.3
營業毛利	382,958	16.4	374,978	15.9	7,980	2.1	132,211	7.0	250,747	189.7
營業利益	289,964	12.4	293,963	12.5	-3,999	-1.4	69,740	3.7	220,224	315.8
稅前息前折舊攤銷前利益	601,316	25.7	716,565	30.4	-115,249	-16.1	545,506	29.0	55,810	10.2
營業外收入(支出)	54,323	2.3	140,838	6.0	-86,515	-61.4	179,404	9.5	-125,081	-69.7
所得稅利益(費用)	-60,814	-2.6	-86,960	-3.7	26,146	-	-18,236	-1.0	-42,578	-
本期淨利	283,473	12.1	347,841	14.7	-64,368	-18.5	230,908	12.3	52,565	22.8
每股盈餘(元)	0.64		0.79		-0.15		0.52		0.12	
每股淨值(元)	26.24		25.94		0.30		26.71		-0.47	

2024年第2季綜合損益表

單位:新台幣千元

項 目	2024年第2季		2024年第1季		較上季差異		2023年第2季		較去年同期差異	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
會計科目										
營業收入	2,337,549	100.0	2,359,653	100.0	-22,104	-0.9	1,880,837	100.0	456,712	24.3
營業成本	1,954,591	83.6	1,984,675	84.1	-30,084	-1.5	1,748,626	93.0	205,965	11.8
營業毛利	382,958	16.4	374,978	15.9	7,980	2.1	132,211	7.0	250,747	189.7
銷管費用	27,979	1.2	23,889	1.0	4,090	17.1	21,876	1.2	6,103	27.9
研發費用	65,015	2.8	57,126	2.4	7,889	13.8	40,595	2.2	24,420	60.2
營業利益	289,964	12.4	293,963	12.5	-3,999	-1.4	69,740	3.7	220,224	315.8
業外收入(支出)	54,323	2.3	140,838	6.0	-86,515	-61.4	179,404	9.5	-125,081	-69.7
稅前淨利	344,287	14.7	434,801	18.4	-90,514	-20.8	249,144	13.2	95,143	38.2
所得稅利益(費用)	-60,814	-2.6	-86,960	-3.7	26,146	-	-18,236	-1.0	-42,578	-
本期淨利	283,473	12.1	347,841	14.7	-64,368	-18.5	230,908	12.3	52,565	22.8
每股盈餘(元)	0.64		0.79		-0.15		0.52		0.12	
每股淨值(元)	26.24		25.94		0.30		26.71		-0.47	

2024年第2季與2024年第1季差異說明

單位:新台幣千元

會計科目	2024年Q2		2024年Q1		差異		差異說明
	金額	%	金額	%	金額	%	
營業收入	2,337,549	100.0	2,359,653	100.0	-22,104	-0.9	營收減少主要因為銷售量減少及平均代工單價增加(匯率及產品組合有利)。
營業毛利	382,958	16.4	374,978	15.9	7,980	2.1	2024年Q2毛利季增2.1%，主要為匯率及產品組合有利，使平均單價增加。
營業費用	92,994	4.0	81,015	3.4	11,979	14.8	2024年Q2營業費用季增11,979千元，主要為推銷管理費用增加4,090千元及研發費用增加7,889千元。
營業利益	289,964	12.4	293,963	12.5	-3,999	-1.4	2024年Q2營業利益季減3,999千元，主要為毛利增加7,980千元、營業費用增加11,979千元。
本期淨利	283,473	12.1	347,841	14.7	-64,368	-18.5	本期淨利季減64,368千元，主要為營業利益減少3,999千元、利息收入減少2,558千元、兌換盈餘減少84,502千元及所得稅費用減少26,146千元。

2024年上半年現金流量

現金流量表

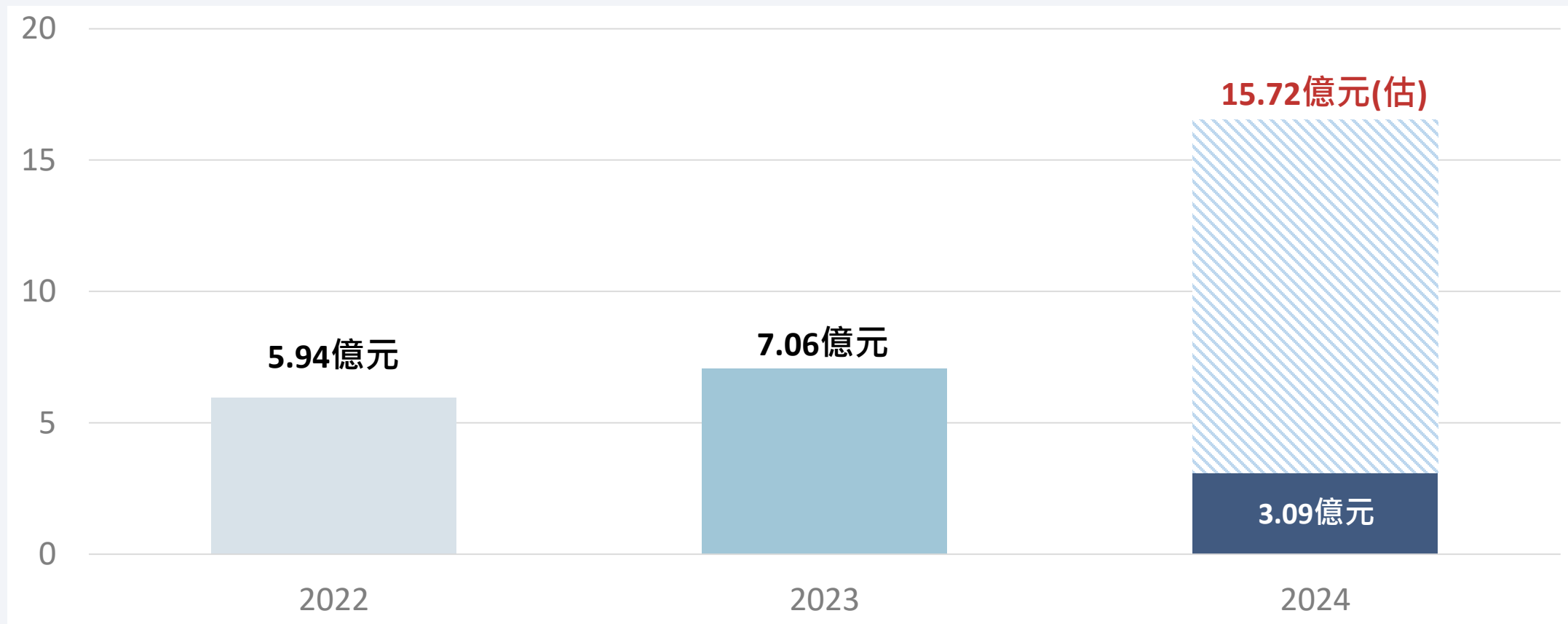
單位:新台幣千元

	2024年Q2	2024年Q1	2024年上半年現金流量	
期初餘額	4,623,193	4,559,135	營業活動之現金流量 869,203	2024/1/1 期初餘額
營業活動之現金流量	643,010	226,193	資本支出 -309,354	2024/6/30 期末餘額
資本支出	-167,701	-141,653	財務活動現金流量及其他 -47,505	
財務活動現金流量及其他	-27,023	-20,482		
期末餘額	5,071,479	4,623,193		
自由現金流量	475,309	84,540		

2024年上半年自由現金流量為 559,849 仟元

歷年資本支出

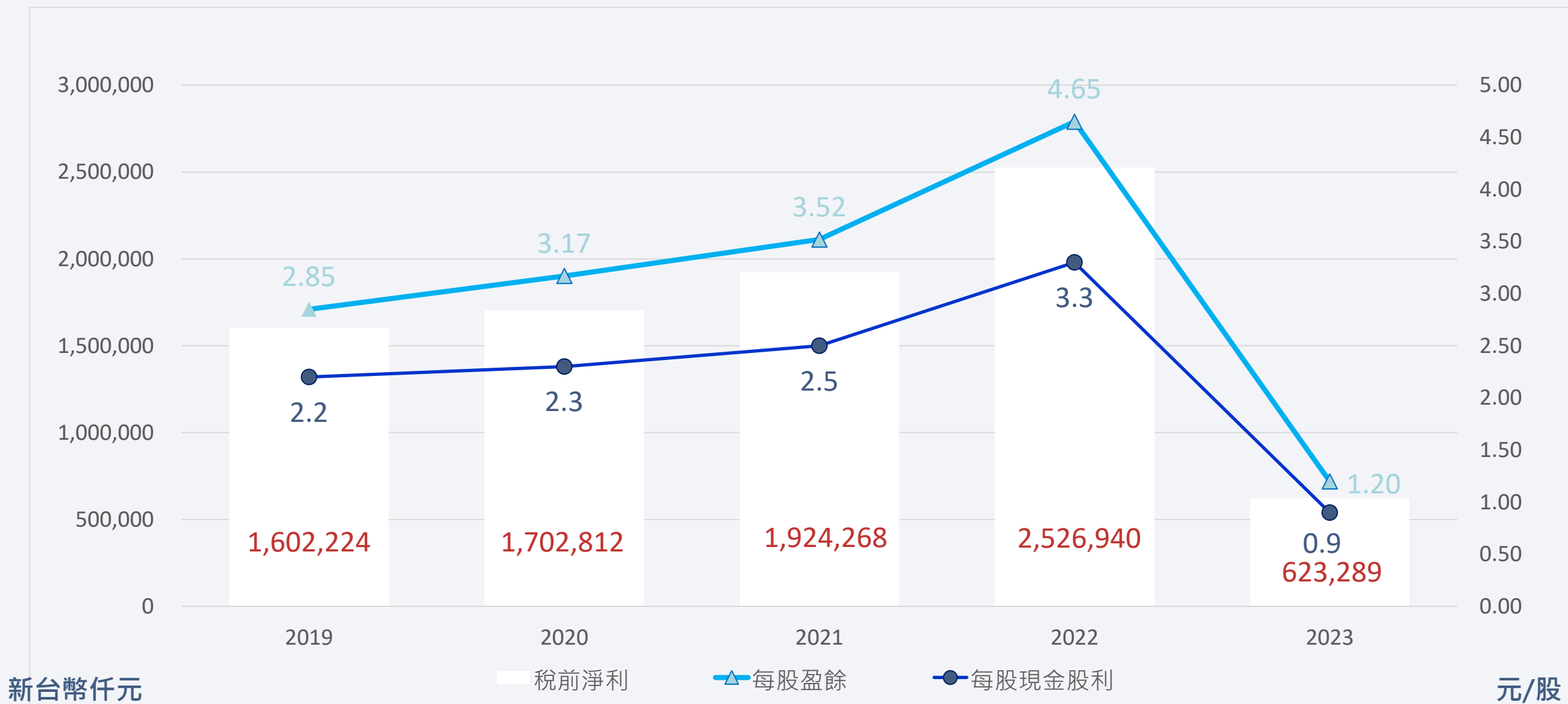
單位:新台幣億元



- 2024年度預估資本支出為新台幣 15.72億元。
- 2024年上半年實際資本支出為 3.09億元。

近5年之稅前淨利、稅後EPS、現金股利

單位:新台幣千元





福懋科技股份有限公司
FORMOSA ADVANCED THCHNOLOGIES CO., LTD

2



研究發展 與規劃

研究發展與規劃

晶圓凸塊(Bumping)及矽穿孔露銅(TSV Reveal)技術發展：

1

因應終端產品體積朝輕、薄、低耗能趨勢，目前正發展晶圓凸塊 (Bumping) 及晶圓重新佈線 (RDL) 技術，除增加產品種類多樣化，並提升產品代工水平。

2

因應記憶體往高容量、高速度及高頻寬記憶體(HBM)發展，採用多晶片堆疊封裝技術將逐漸增加，積極研究開發3D矽穿孔露銅(3D TSV Reveal)製程技術，並往DDR5產品開發，強化先進封裝技術能力，提升產品競爭力。



福懋科技股份有限公司
FORMOSA ADVANCED THCHNOLOGIES CO., LTD

3



營運重點
與
市場展望

營運重點

1

AI應用逐漸推出，搭載記憶體容量增加，將帶動高階記憶體需求成長。2024年上半年記憶體產業雖有小幅復甦，但受消費性電子產品市場走弱影響，IC封測代工需求短期仍顯保守。

2

傳統PC與NB市場已成熟，標準型記憶體模組代工需求相對較穩定，電競記憶體模組代工因市場走弱需求減緩。

3

因應記憶體產品朝高速大容量發展，持續進行覆晶(Flip Chip)、晶圓凸塊(Bumping)、重新佈線(RDL)、與矽穿孔露銅(TSV Reveal)等技術開發。

市場展望

1

第三季DDR3、DDR4市場需求略顯遲緩，但在大廠產能限縮及AI應用的推動下，預期2024年整體市場供需可望逐漸均衡。但因整體市場需求仍保守，封測代工需求短期不易大幅提升。地緣政治風險、美中科技競爭及地域性經濟疲弱等因素仍持續影響市場需求復甦力道。

2

AI手機與AI PC陸續推出，預期帶動記憶體需求增加。DDR5產品市場需求成長，本公司將配合客戶推出DDR5記憶體產品。

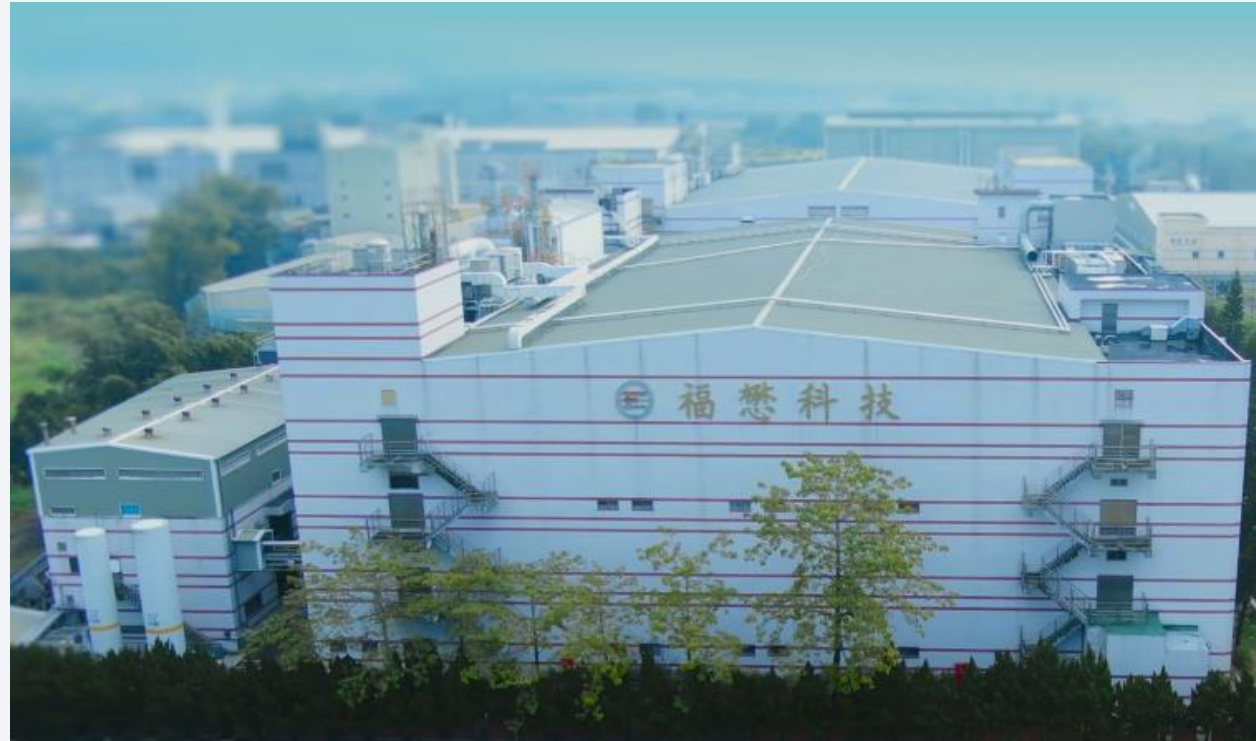
3

電競記憶體模組市場需求仍持平，但DDR5比重逐漸增加。第四季進入傳統旺季，在電子商務銷售與換機需求帶動下，模組代工預估將溫和成長。



福懋科技股份有限公司
FORMOSA ADVANCED THCHNOLOGIES CO., LTD

4



問與答